

# 光通讯模块低应力导热片材料原厂家定制汇为

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 光通讯模块低应力导热片材料原厂家定制汇为               |
| 公司名称 | 汇为热管理技术（东莞）有限公司                    |
| 价格   | 1.20/个                             |
| 规格参数 | 品牌:Huiwell<br>型号:HW-020NS<br>产地:中国 |
| 公司地址 | 东莞市企石镇铁炉坑村湖滨南路                     |
| 联系电话 | 18938207451                        |

## 产品详情

汇为热管理技术有限公司(Huiwell ThermalManagement Tech)

我们是国内早从事热管理材料销售运营的公司之一,公司早期主要负责国际导热材料品牌在中国区的销售和服务。历经多年的行业积累和沉淀,转型热管理材料的设计开发、生产制造以及销售服务。公司目前分为热管理材料和整机散热设计两大事业集群,致力于为各个领域客户提供一站式热管理技术及产品解决方案。

基于我们对客户服务的坚定承诺,加上我们对产品质量的永恒追求,我们致力于为客户提供了一个可以信赖的供应链。我们专注于各个领域电子产品的热管理服务,潜心为用户提供优秀的热管理材料和散热设计解决方案;我们期待帮您解决产品热量管理(控制)这一问题。

汇为热管理不含硅材料HW-020NS简介:

HW-020NS不含硅导热垫片是一款由高导热陶瓷和其他填料构成的无硅导热材料,它的导热系数达到2.0 W/m-k,不含硅成分,在工作过程中不会释放或挥发出硅氧烷成份,因此适用于那些对硅析出敏感的应用场合,如光学器件、光通讯、军工雷达等其他只能使用无硅导热材料的应用场合,无硅导热垫片也具有优秀的绝缘性能、柔软等特性,能够充分填充发热器件(如芯片)与散热器或壳体之间的空气间隙,完

成优秀的热量传递。

特点/优势：

不含硅

优秀的导热性能，导热系数 $2.0\text{W/m}\cdot\text{k}$

表面粘性可选，能贴附在器件或散热器表面

柔软，变形力低，可应用于应力较小、热负荷较大的场合

提供多种厚度规格，可解决结构件公差叠加带来的大间隙问题

典型应用：

工控电脑

光通讯电子、光学器件

汽车电子、军工雷达

存储设备

其他硅敏感设备